



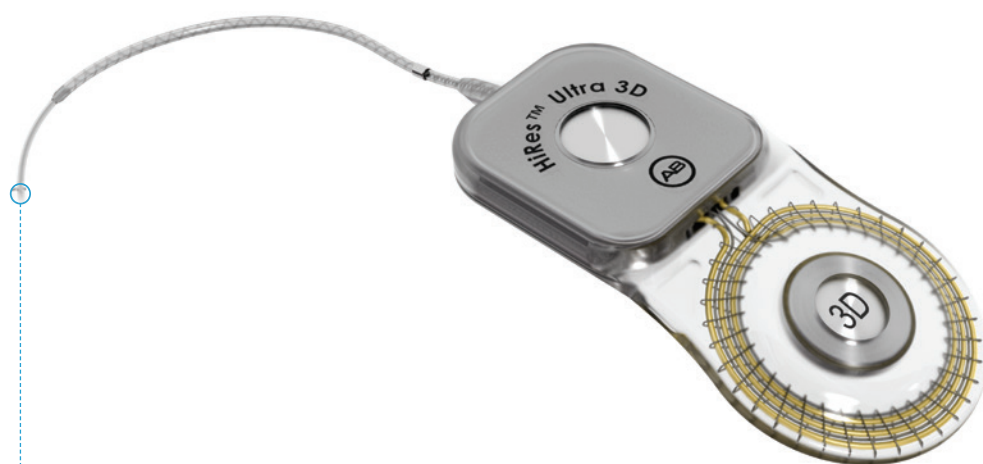
Especificaciones técnicas

IMPLANTE COCLEAR HIRES™ ULTRA 3D

La base para una mejor audición

El nuevo implante coclear HiRes™ Ultra 3D se ha diseñado para ofrecer todas las ventajas de la plataforma del implante HiRes Ultra pero con una solución para RM sin complicaciones. Con un diseño novedoso¹ que permite que el montaje multiimán no se mueva en exploraciones de RM de alta resolución de 3 T, su paciente puede someterse a una RM sin dolor y disfrutar de una audición sin interrupciones.

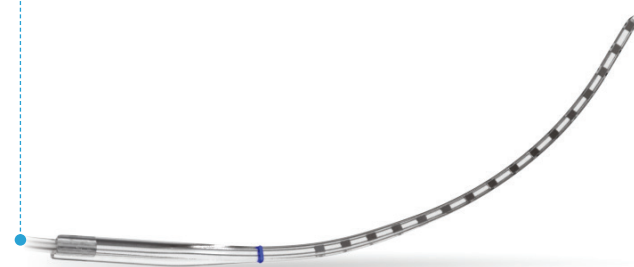
Desarrollado con cirujanos de implantes cocleares líderes y utilizando modernos procesos de fabricación, el HiRes Ultra 3D con los electrodos HiFocus™ SlimJ y HiFocus™ Mid-Scala ofrece características únicas diseñadas para adaptarse a la anatomía del paciente y a las preferencias quirúrgicas a fin de lograr los mejores resultados de audición posibles.



Implante coclear HiRes™ Ultra 3D



Electrodo HiFocus™ Mid-Scala



Electrodo HiFocus™ SlimJ



Vista lateral

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMPLANTE

Velocidad de actualización de la información	90 kHz
Velocidad de estimulación	Hasta 83 000 pps (limitado por el software)
Circuitos de salida independientes	16
Bandas espectrales	Hasta 120 sitios de estimulación (limitado por el software)
Enlace de comunicación	Enlace inductivo bidireccional
Función de seguridad IntelliLink™	Asociación entre implante y procesador
Diagnóstico	Imágenes de respuesta neural (NRI), mediciones de impedancia, ESRT, prueba de integridad
Velocidad de muestreo de resolución ADC	Resolución: 9 bits, velocidad de muestreo: 25 kHz
Amplitud y ancho de pulso	0-2040 µA y 10,78-229 µS
Exactitud de la impedancia	2,5 kΩ

ESPECIFICACIONES DE ENTREGA DE ESTIMULACIÓN

Estrategias HiRes Fidelity 120™	HiRes Optima*-P (pareada), HiRes Optima*-S (secuencial), ClearVoice™ *, HiRes-P con Fidelity 120™* (pareada), HiRes-S con Fidelity 120™* (secuencial)
Estrategias de sonido HiResolution™	HiRes-P (pareada) y HiRes-S (secuencial)
Estrategias convencionales	Modos CIS y MPS

MATERIALES Y DIMENSIONES DEL IMPLANTE

Carcasa de titanio	Carcasa con 4,5 mm de titanio que contiene silicona
Bobina inductiva de la antena	3,6 mm de silicona en la bobina inductiva de la antena
Alojamiento	25/28,5 mm × 56,2 mm de silicona flexible
Peso	11 gramos
Volumen	4800 mm³
Montaje multi-ímán	Neodimio dentro de una carcasa de titanio
Bobina inductiva de telemetría	Cable trenzado en oro y cable revestido de platino en silicona flexible. Reforzada con fibra de polímero de alta densidad
Conexión a tierra	2: una conexión a tierra en carcasa y una conexión a tierra en electrodo de anillo
Valor de resistencia a los impactos	Supera los requisitos de impactos especificados en EN45502-2-3:2010
Información del entorno presurizado	Puede soportar presión a una profundidad de hasta 42 m (138 pies) debajo del agua o una presión manométrica de 4 ATM (413 kPa)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ELECTRODOS

	HiFocus SlimJ	HiFocus Mid-Scala
Electrodos	16 contactos de platino; cables de platino e iridio; portador flexible de silicona; conexión a tierra integrada en el conductor	
Mínima área de contacto expuesta	0.12 mm²	0.12 mm²
Espacio entre los contactos	1.3 mm	0.975 mm
Longitud activa	~20 mm	~15 mm
Pinzas	Sí	Pueden utilizarse pinzas de punta fina o un instrumento similar
Herramienta de inserción	–	Opcional
Manos libres	Sí	Sí
Recargable	–	Máximo 2
Inserciones	Máximo 3	Máximo 3
Inserción recomendada	Ventana redonda, ventana redonda ampliada y cocleostomía	

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS: PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL, CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE USO (REF.) DEL SISTEMA.

Montaje multi-ímán	Se puede dejar colocado para exploraciones de RM de 3 T y de 1,5 T (no se necesita vendaje) o se puede retirar con facilidad en caso necesario. Consulte el folleto sobre información de seguridad de RM.
Instrumentos electroquirúrgicos	Puede utilizarse un cauterio monopolar fuera de la cabeza y el cuello, y uno bipolar a 1 mm del implante.
Estimulación eléctrica extracorporal	Las sondas no deben situarse por encima del implante.
Neuroestimulación	No directamente sobre el implante.
Diatermia	Puede aplicarse diatermia tanto de onda corta como de onda larga de forma segura.
Radiación	250 Gy con una intensidad del haz de 15 MeV y a una profundidad de 3 cm. Pueden utilizarse de forma segura las técnicas de diagnóstico por la imagen como las TC, las radiografías, las mamografías, etc.
Ecografía con valor diagnóstico	Se puede utilizar de forma segura.

* No aprobado para uso pediátrico en Estados Unidos.

REFERENCIAS:

1. Lee et al. (2018). U.S. Patent No. 9,919,152B2. Valencia, CA: U.S. Patent and Trademark Office.

Para obtener más información, visite
ADVANCEDBIONICS.COM



Advanced Bionics AG

Laubisrütistrasse 28,
8712 Stäfa, Switzerland
T: +41.58.928.78.00
F: +41.58.928.78.90

info.switzerland@advancedbionics.com

Advanced Bionics LLC

28515 Westinghouse Place
Valencia, CA 91355, United States
T: +1.877.829.0026
T: +1.661.362.1400
F: +1.661.362.1500

info.us@advancedbionics.com

Para obtener información sobre otras ubicaciones de AB,
visite *advancedbionics.com/contact*

AB - A Sonova brand

Póngase en contacto con su representante local de AB
para obtener información sobre la aprobación regulatoria y
la disponibilidad en su región.